



**武汉光安伦光电技术有限公司**  
WUHAN AROPTICS-TECH CO., LTD



地址：湖北省鄂州市葛店开发区光谷联合科技城C9-5（研发生产中心）

湖北省武汉市光谷大道金融港B26栋801（营销中心）

电话：0711-3701688

网址：[www.aroptics-tech.cn](http://www.aroptics-tech.cn)

邮箱：[daixibing@aroptics-tech.cn](mailto:daixibing@aroptics-tech.cn)



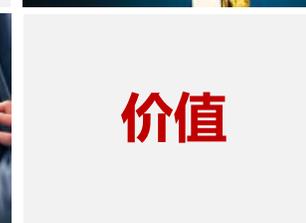
**真诚**



**创新**



**坚持**



**价值**



# 目录/Contents



创新



真诚



坚持



价值



01. 关于企业
02. 产品介绍
03. 市场情况
04. 发展规划
05. 人才引进
06. 岗位要求

01  
Part

# 关于企业

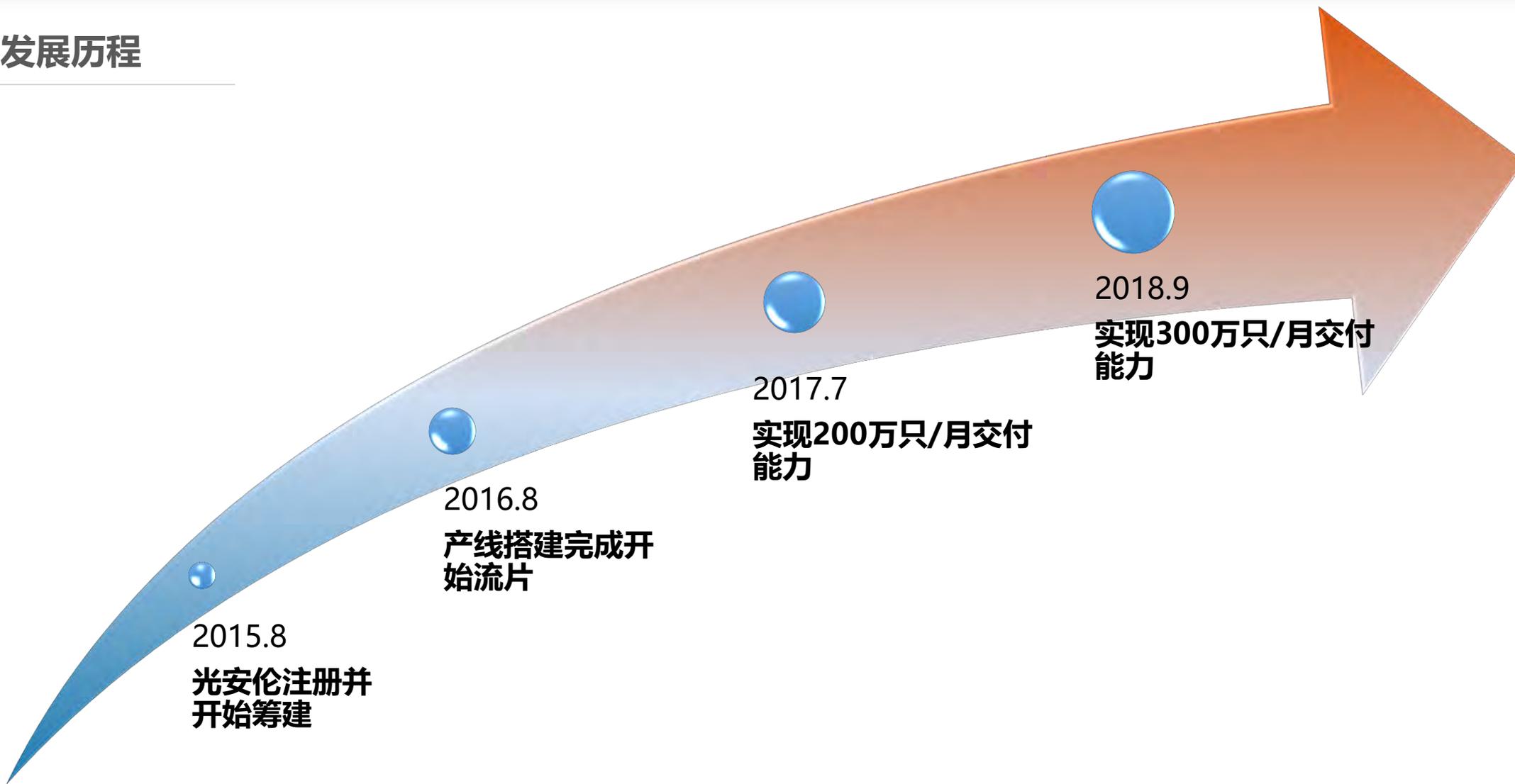
## 1.1 企业简介



武汉光安伦光电技术有限公司于2015年8月成立，注册资本1275万元，总投资额2亿元。公司是目前国内光通信行业领先的专业独立从事光电子芯片外延生长、芯片设计与制作、工艺开发及封装的生产厂家，产能2KK对/月，产品主要应用于光纤通讯以及光纤传感领域。

公司现有员工约150人，其中领域卓有成绩的专家及核心技术人员约30人，依托于武汉大学以及华中科技大学、武汉理工大学等知名学府，建立了强大的研发团队，在10G及单路25G芯片，100G集成芯片高速光芯片领域已经取得重大进展，并拥有多项发明专利。

## 1.2 发展历程



## 1.3企业文化



核心价值观

抱诚守真 戮力创新 持之以恒

企业愿景

创立国际一流的光电子芯片品牌

企业使命

提供有竞争力的光电子领域服务，持续为客户创造价值

## 1.4 团队介绍

公司依托于武汉大学以及华中科技大学、武汉理工大学及国外部分知名学府，建立了强大的研发团队，我们为客户提供最好的产品、良好的技术支持、健全的售后服务

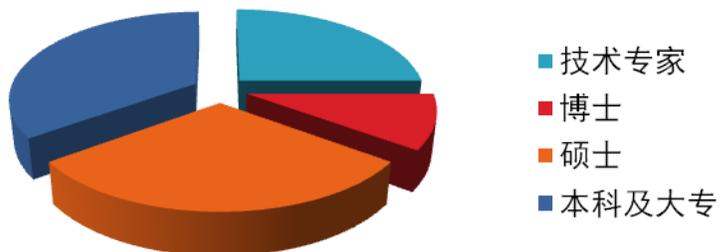


公司核心专家

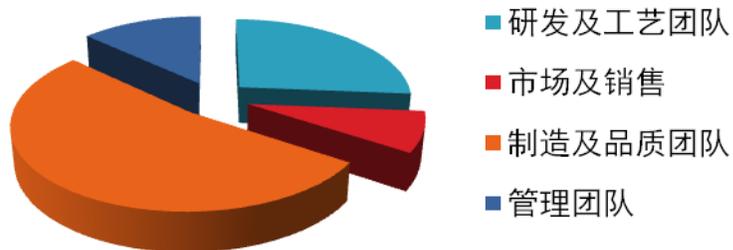
## 1.4 团队介绍

公司核心技术团队成员约10人，来源于华中科技大学、武汉大学、中国国家半导体所等国内光电子领域的一流科研机构和企业，外部专家包括加拿大Mcmaster大学、美国JDSU、英国Intense等在国外具有多年科研和生产经验的专家，团队硕士以上占比60%，在半导体行业的工作经验10-20年。

### 技术人员学历组成



### 人员岗位职责组成



### 人员年龄组成



02  
Part

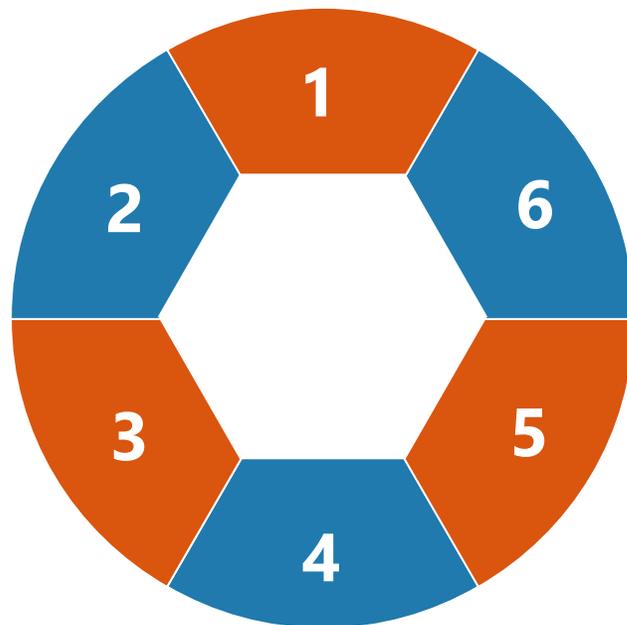
# 产品介绍

## 2.1 主要产品

| **2.5G** 1310/1550nm FP  
1310nm FP EPON  
1310 DFB GPON

| **2.5G** 1490nm DFB  
1550nm DFB  
1270nm DFB

| **25G** PIN /APD  
CWDM DML

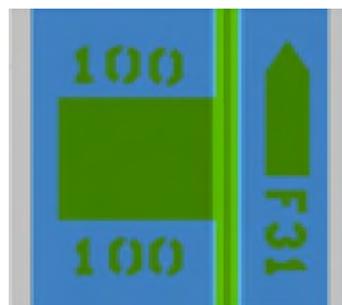


| **10G** APD  
1310FP  
O波CWDM DFB

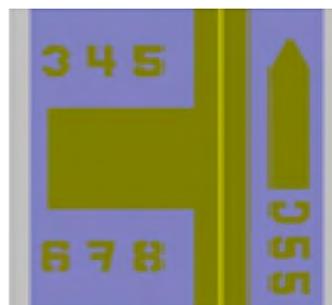
| **10G** 1270nm DFB  
1577nm EML  
1550nm EML

| **25G** 1310 DFB工业级  
1310 FP工业级

## 2.2 产品展示



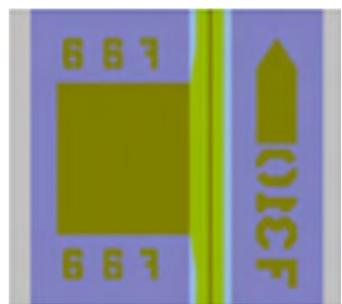
1310/1550nm DFB/FP



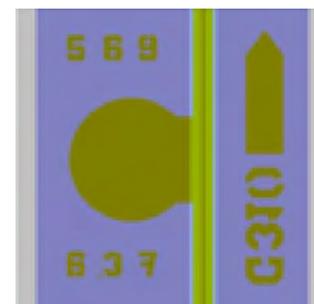
1490/1550nm BH-DFB



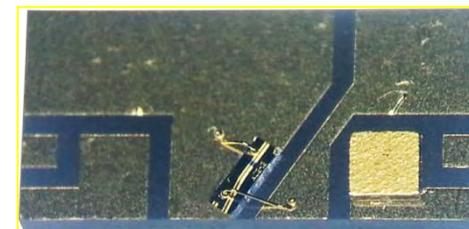
PIN



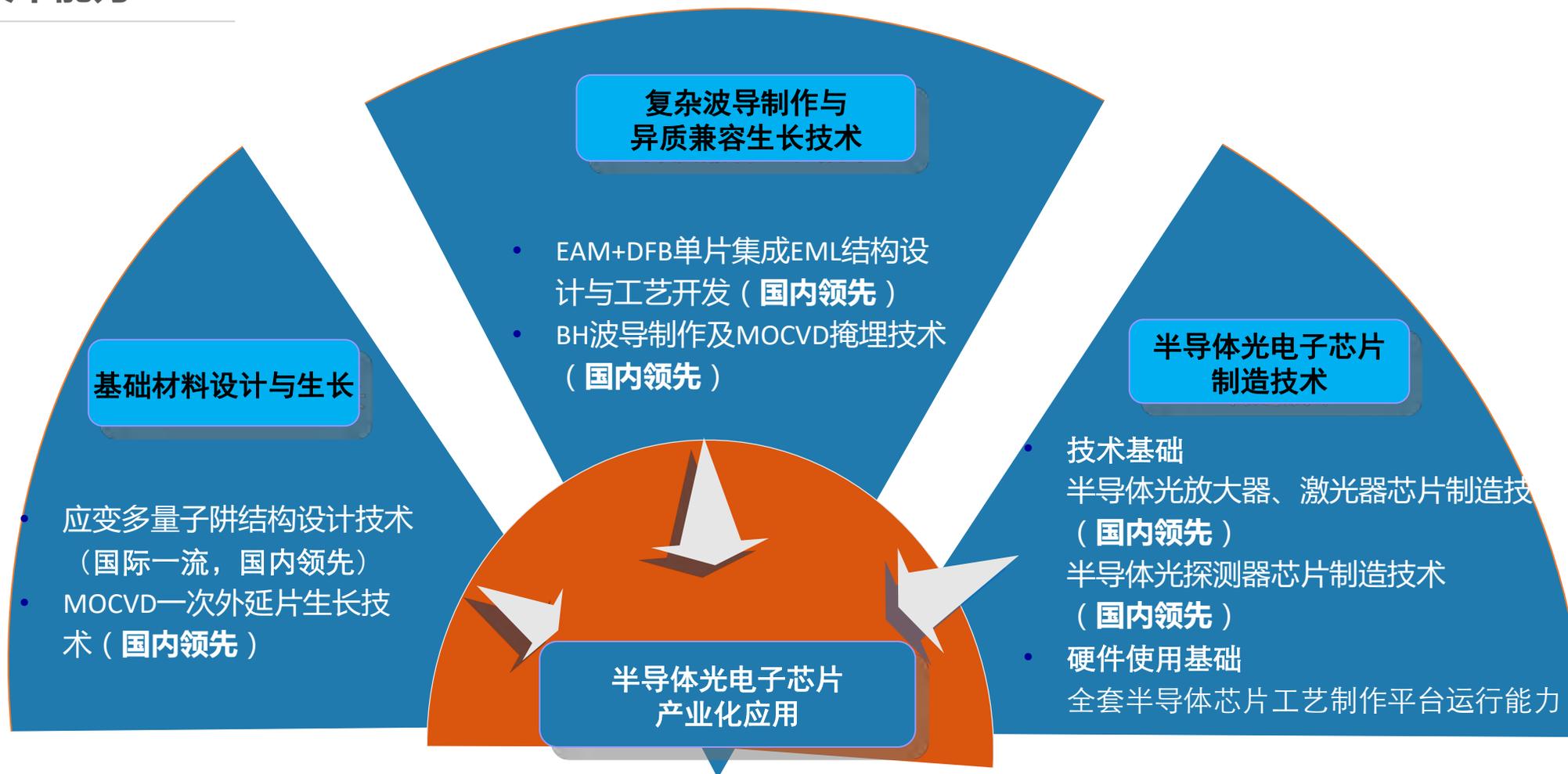
1310nm FP



1490/1550nm BH-DFB



## 2.3 技术能力



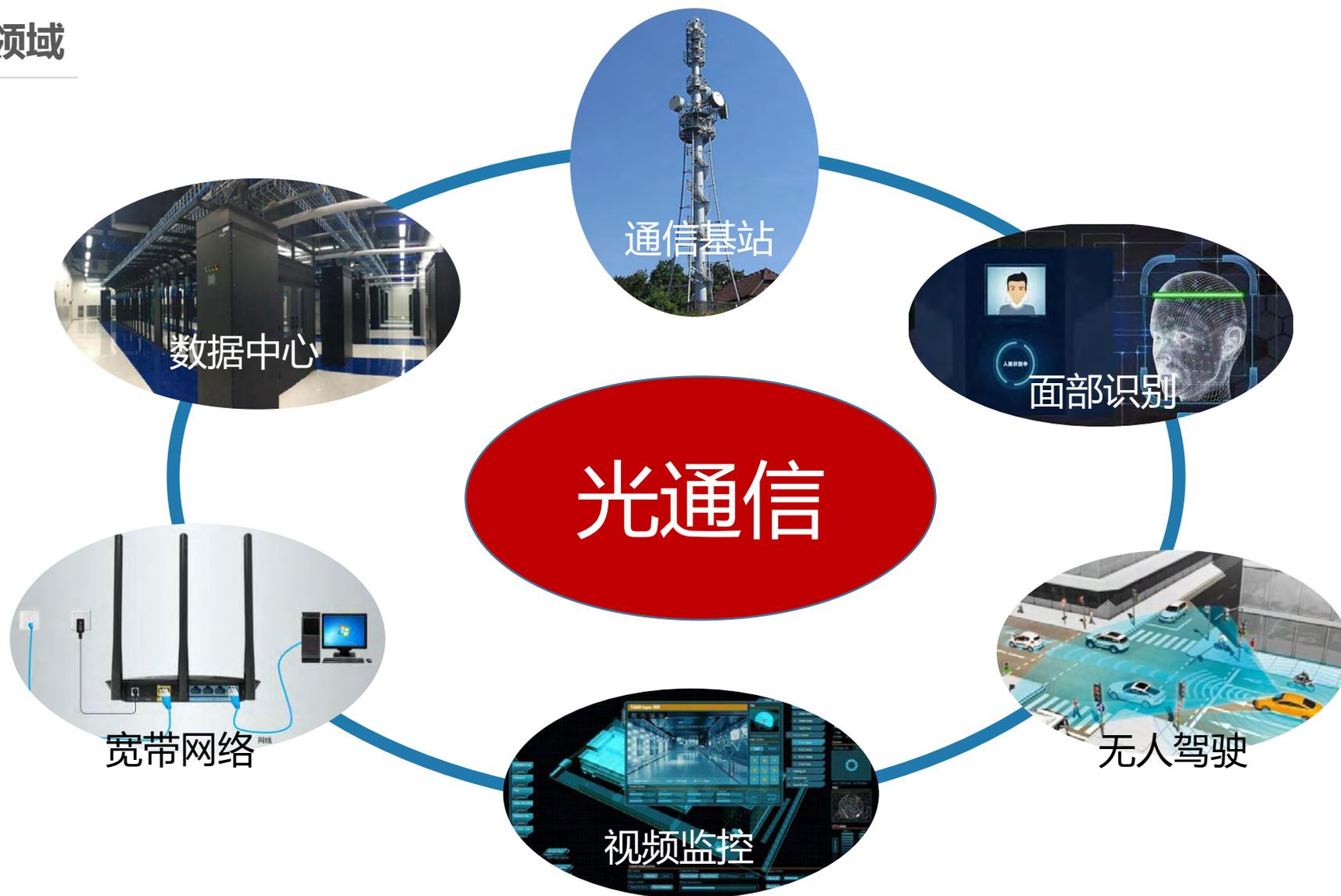
## 2.4 部分核心技术及应用

序号	技术名称	应用产品
1	AlGaInAs材料 + BH型波导制作技术	10G 高速PON
2	基于MOCVD平台的元素扩散技术	2.5G P2P 10G 高速PON
3	RM + RWG波导制作技术	2.5G P2P 10G 高速PON
4	基于DFB、DBR的高速激光器设计技术	PON
5	应变补偿型多量子阱设计技术	10G 高速
6	调制掺杂型多量子阱设计技术	2.5G P2 10G 高速PON
7	弯曲波导设计、制作技术	军工
8	MESA型半导体加工技术	2.5G P2 10G 高速PON
9	异质兼容型集成设计及制作技术	10G 高速PON

03  
Part

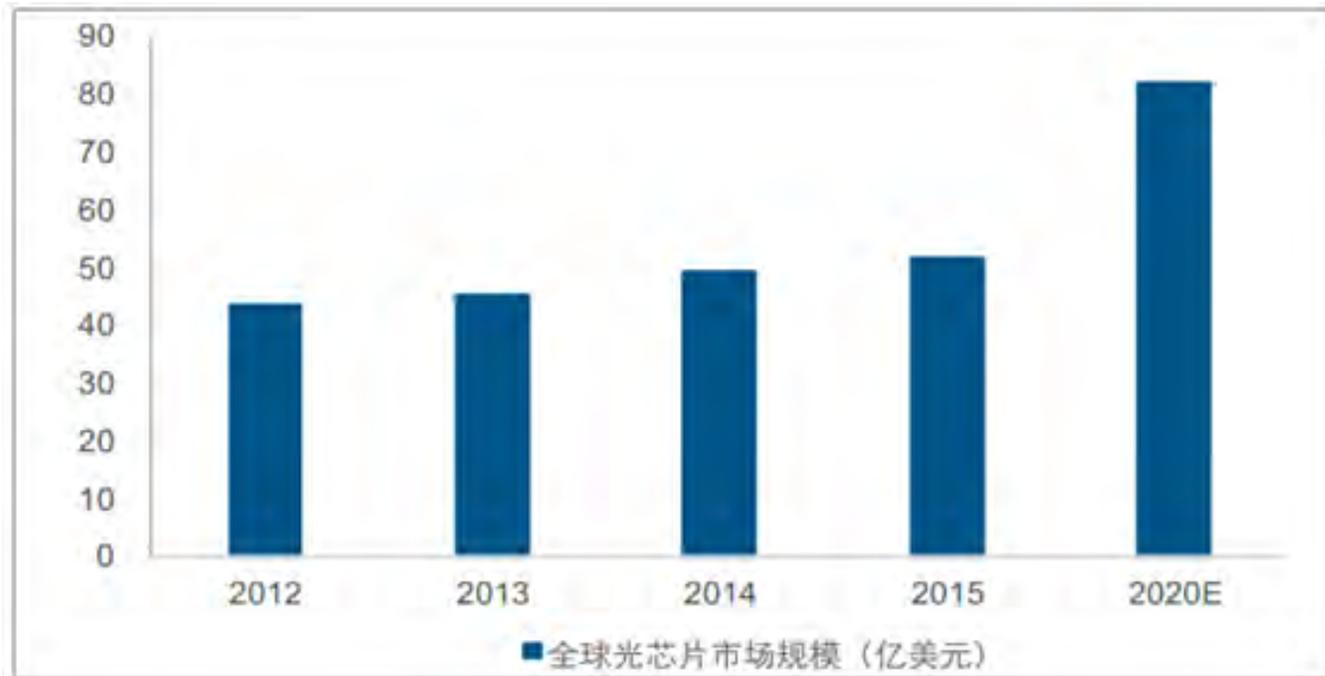
# 市场情况

### 3.1 产品应用领域



### 3.2 产品市场规模

#### 全球光芯片市场规模



数据来源：中国产业信息网

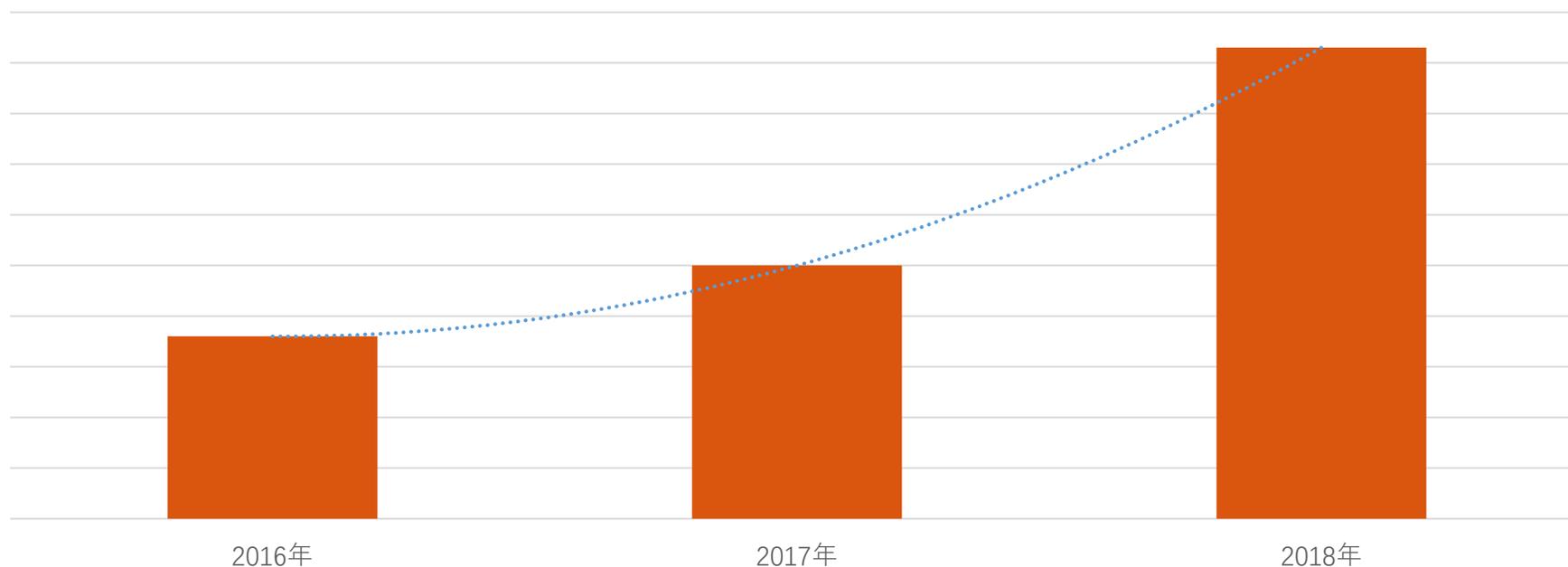
#### 国内光芯片市场规模



图 表1：国内光芯片市场规模有望加速拓展（计入3D 感应VCSEL 芯片）资料来源：ICCSZ

### 3.3 公司产品市场

公司立足于10G及以下速率的DFB、APD、FP、PIN等光收发芯片稳定供应的同时，跟踪高速芯片的技术前沿，目前在高速光芯片领域拥有多项发明专利，如单路25G芯片，100G集成芯片领域已经取得重大进展。



04  
Part

# 发展规划

## 4.1 公司发展规划

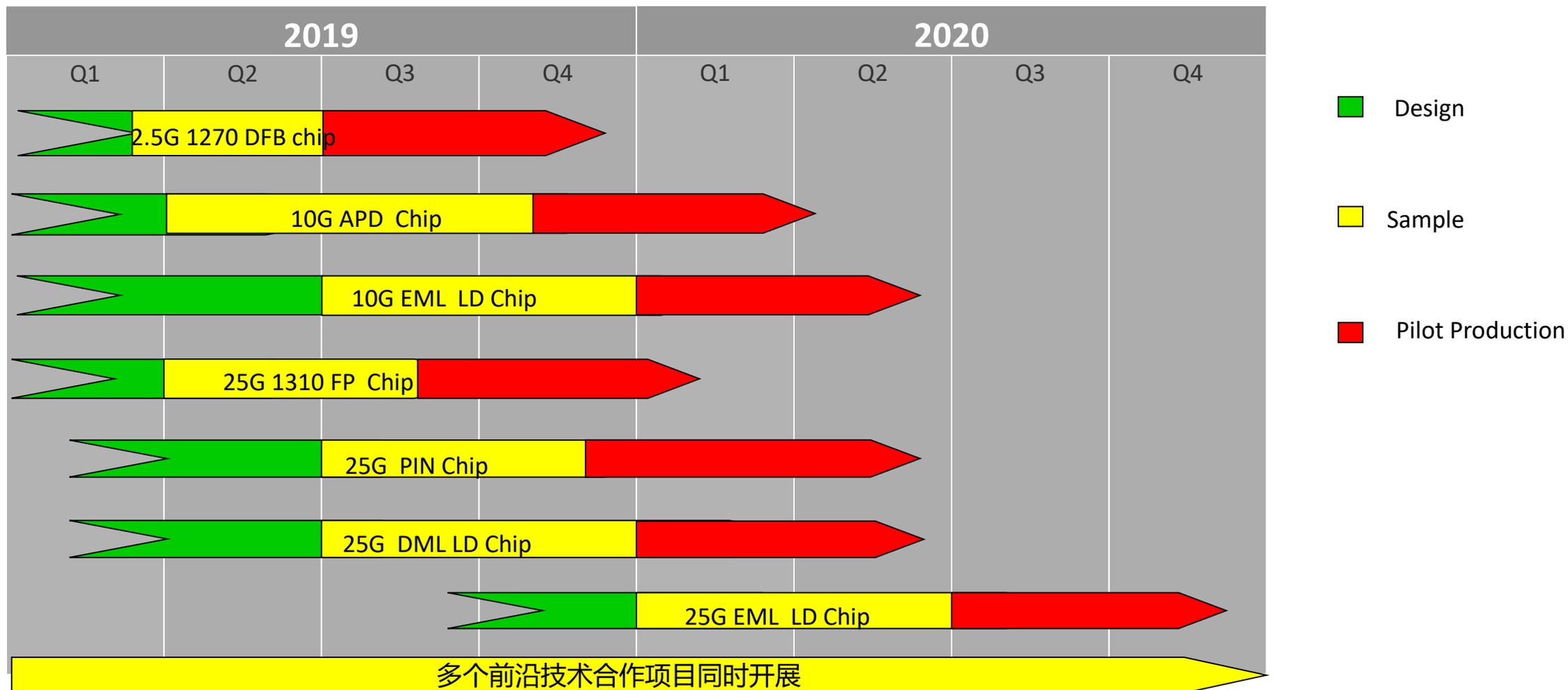
### □ 公司建设目标

建立一条从材料外延—半导体微纳米加工—芯片解理、镀膜—芯片测试、封装的具有先进水平的半导体光电子芯片生产线；实现2.5Gbps FP&DFB、APD芯片的批量生产，产能规划 $\geq 1\text{KK}/\text{M}$ ；10Gbps DFB、PIN芯片的批量生产，产能规划 $\geq 500\text{K}/\text{M}$ ；4×10Gbps WDM芯片的批量生产，产能规划 $\geq 50\text{K}/\text{M}$ 。

### □ 公司经营目标

国际上首屈一指的光芯片供应商。

## 4.2 产品开发规划



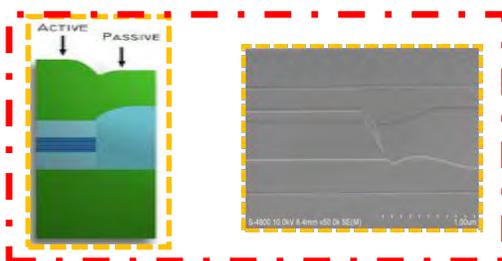
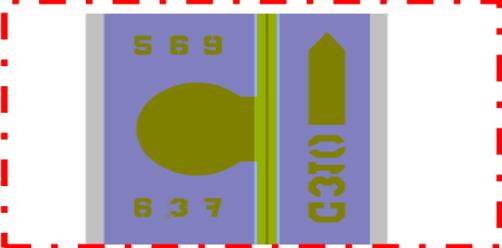
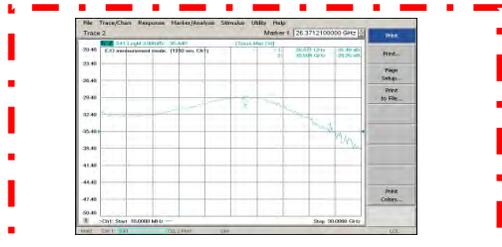
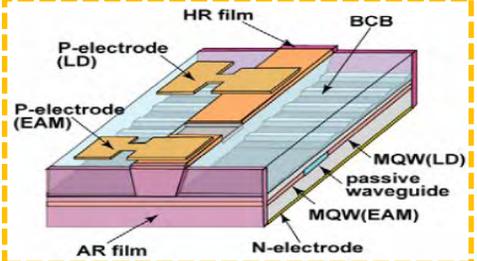
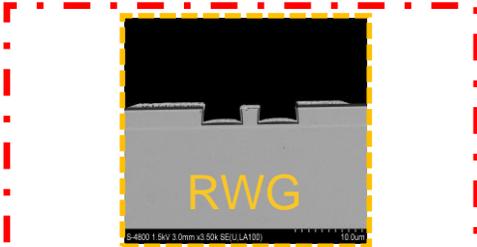
### 4.3 产品开发方向

DML

EML

10G

25G

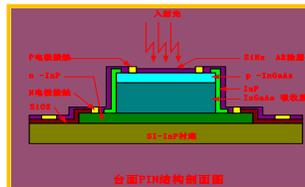


- ◆ 减小寄生电容 ( BCB ) ;
- ◆ 外延片优化设计
- ◆ 短腔设计 ( 200~150um )
- ◆ AlGaInAs 材料BH掩埋工艺

- ◆ Butt-joint技术
- ◆ 高ER
- ◆ 高速率实现
- ◆ 集成化实现

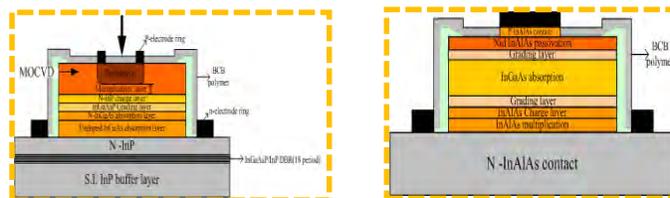
### 4.3 产品开发方向

10G PIN



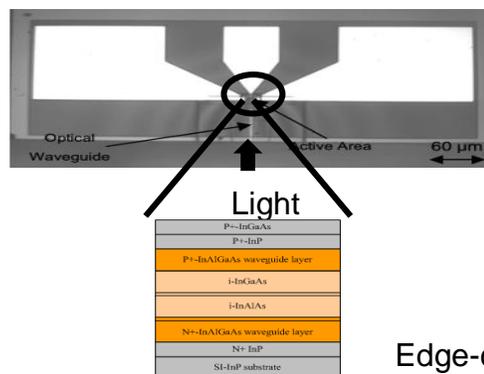
- ◆ MESA、BCB/I-InP侧面钝化，P/N同面电极

10G APD



- ◆ MESA、DBR、Multi-layer设计，背向进光

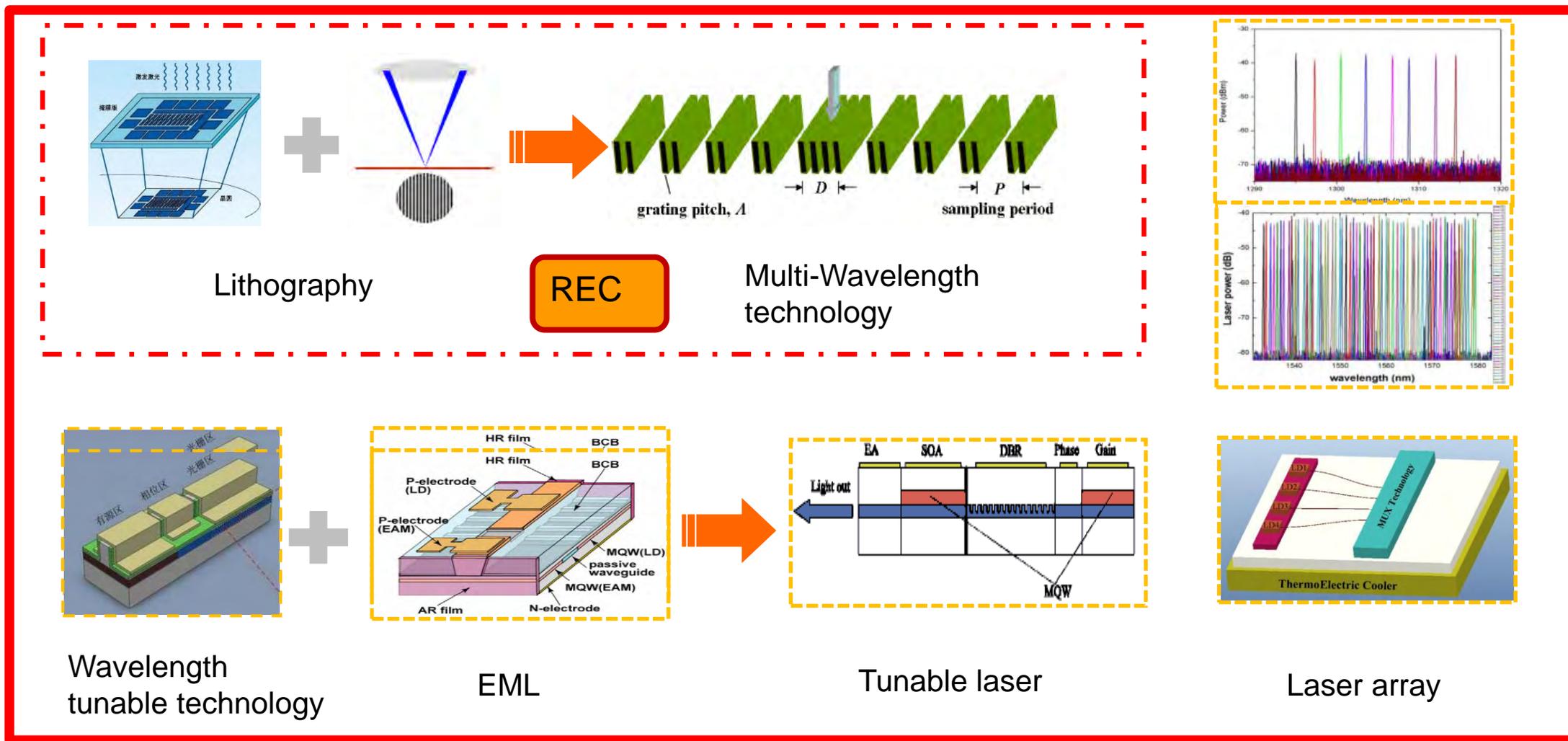
25G PIN/APD



- ◆ 边耦合波导 (Edge-coupled) 设计
- ◆ 侧面进光，量子效率高，
- ◆ 低吸收层厚度、高响应速率

Edge-coupled

### 4.3 产品开发方向



05  
Part

# 人才引进

## 5.1 研发硬件平台



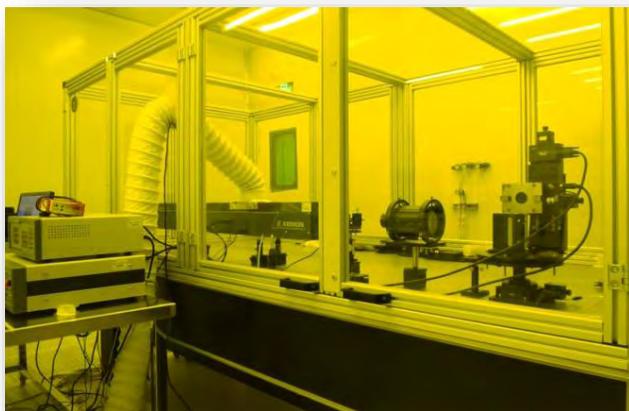
MOCVD



PD测试台



chiptester



全息光栅曝光系统



划片机

裂片机



光刻机

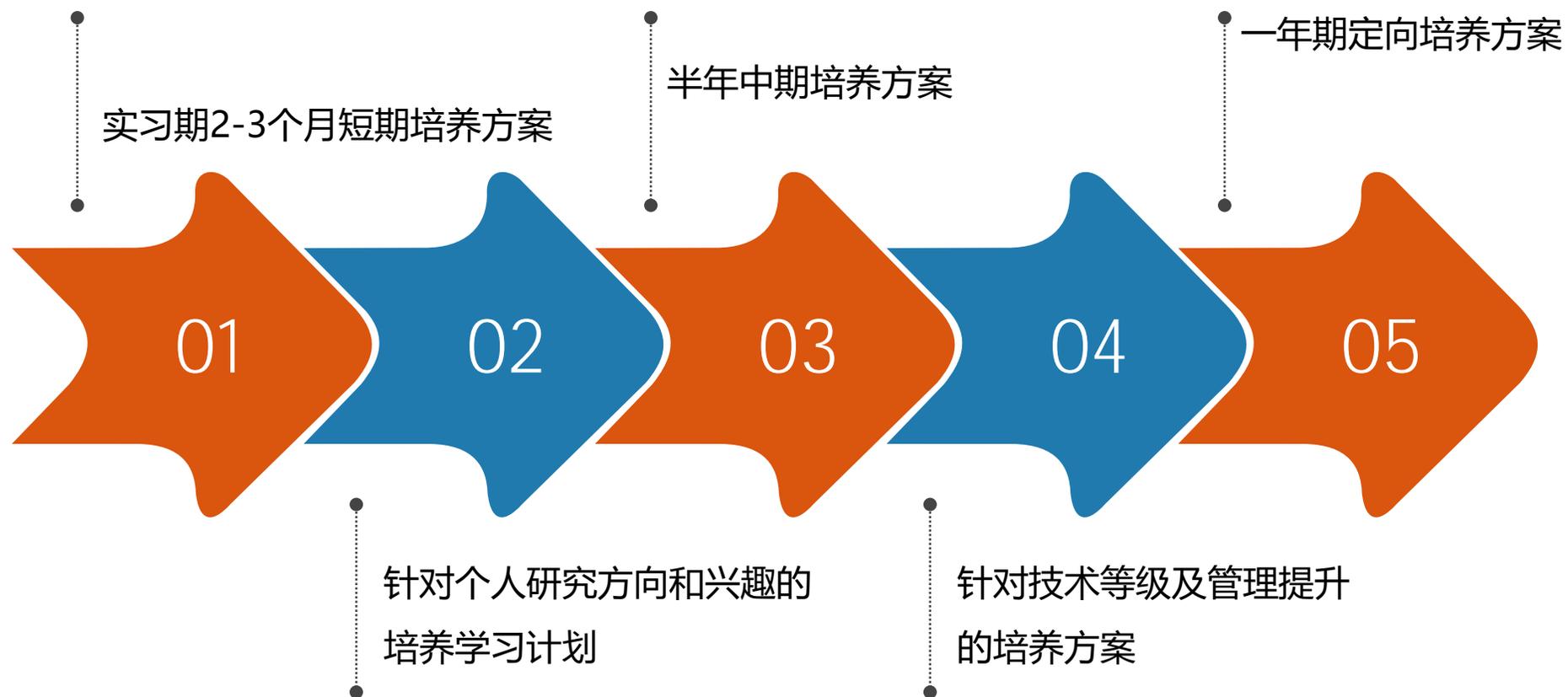
## 5.2 优秀研发团队

- 李博士，首席科学家（ Chief Scientist ），技术专家，中国北京交通大学工学博士毕业，加拿大麦克马斯特大学电子与计算机工程系教授。主要进行光电子器件的设计、模拟、制作及封装等技术指导工作，为新产品的设计和开发提供解决方案。
- 肖博士，技术专家（ Technical Expert ），美国奥本大学材料工程博士毕业，曾任美国JDSU公司高级工程师。专门从事III-V族光电子器件开发和生产，参与JDSU激光光导介电系数渐变的非对称性异质结构设计；掌握先进的激光半导体的生产技术和工艺，精于外延生长掺杂和选择性扩散混杂。项目。
- 仇博士，技术专家（ Technical Expert ），英国哥拉斯格大学电子学与电器工程博士毕业，曾任英国 Intense Ltd公司技术专家。研究方向：为半导体光电子器件集成技术与器件，一直从事物理电子技术方向的研究，致力于光通讯器件的光子集成技术及器件。

### 5.3 部分校招人才

- 25G项目负责人陈某，武汉大学微电子专业博士，现为25G发射端5G通信重点产品产品研发项目负责人
- 10G PON项目负责人张某，北京科技大学材料物理专业硕士，负责中低速发射产品，为10G PON发射芯片主力负责人
- 核心技术骨干王某，武汉理工大学材料加工专业硕士，集成类发射芯片负责人，主责EML、tunable laser产品开发，核心技术人员
- 核心技术骨干郭某，湖北大学硕士，华科博士在读，高端接受芯片负责人，主责25G PD产品开发，核心技术人员
- 核心技术骨干李某，武汉工程大学材料学专业硕士，中低速发射产品项目组核心技术成员，核心技术人员

## 5.4 培养体系



## 5.5 薪资体系

短期

基本工资

+

月度绩效工资

+

津贴补贴

中期

项目奖金

+

效益奖金

长期

股权激励

福利

节日福利

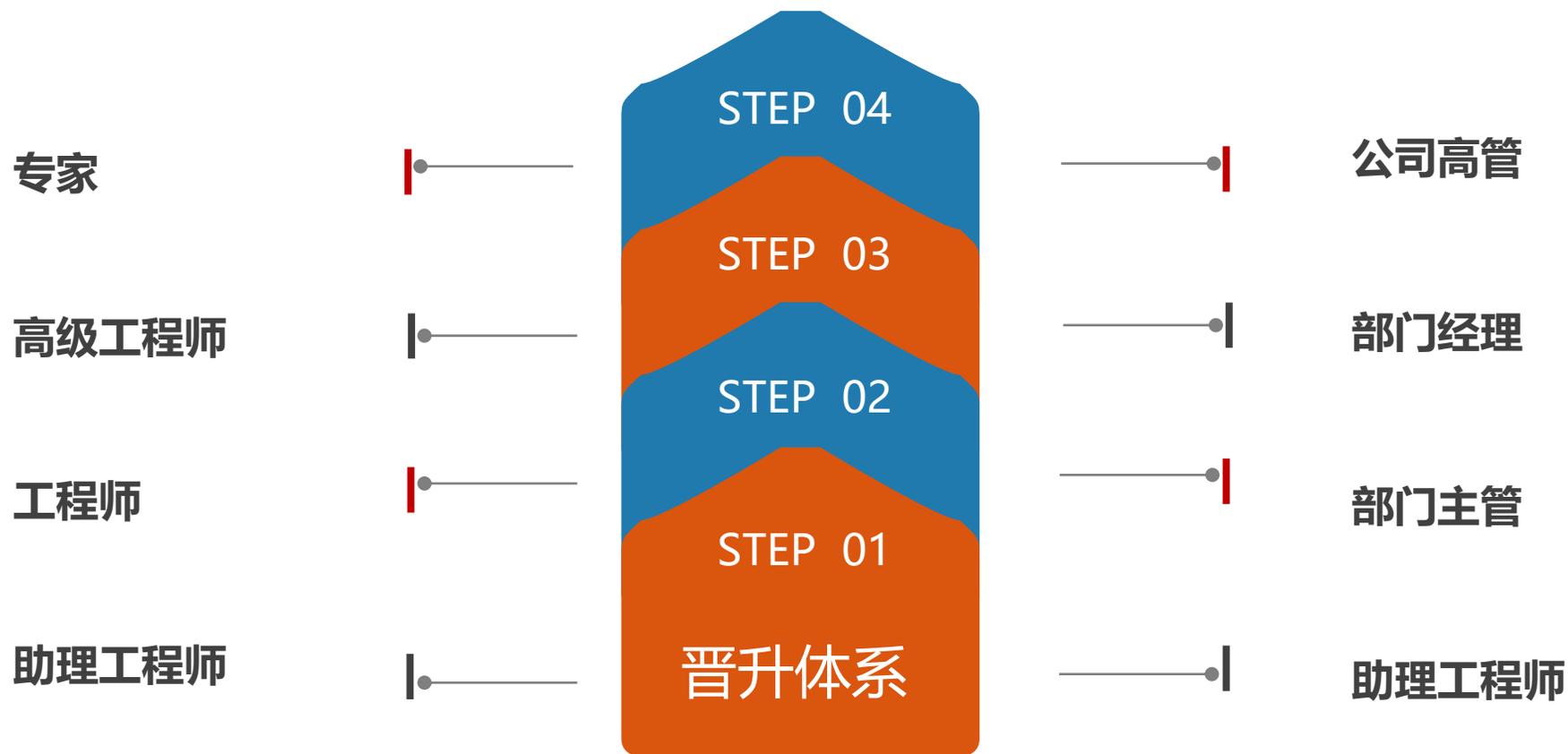
+

带薪年假

+

年度体检

## 5.6 晋升体系



06  
Part

岗位要求

## 6.1 岗位要求

### 产品开发工程师

#### 职责描述：

- 1.参与公司新产品的研发及项目研发计划的制订；
- 2.参与产品指标技术方面的评审；
- 3.参与新产品相关的工艺开发；
- 4.新产品、新技术专利的编制和申请；

#### 任职资格：

- 1.硕士及以上学历，光学、微电子、物理及相关专业；
- 2.有相关课题及项目研究成果者优先；
- 3.有团队合作精神，能承担研发工作压力。

### 工艺开发工程师

#### 职责描述：

- 1.参与公司新产品研发项目，完成工艺部分开发；
- 2.参与产品工艺提升项目，完成产品工艺升级；
- 3.产品新材料技术的研发；
- 4.新技术专利的编制和申请；

#### 任职资格：

- 1.硕士及以上学历，材料、高分子、化学及相关专业；
- 2.有相关课题及项目研究成果者优先；
- 3.有团队合作精神，对新材料领域关注，能自主学习。

# 谢谢聆听



创新



坚持



真诚



价值



地址：湖北省鄂州市葛店开发区光谷联合科技城C9-5（研发生产中心）  
湖北省武汉市光谷大道金融港B26栋801（营销中心）

电话：0711-3701688

网址：[www.aeroptics-tech.cn](http://www.aeroptics-tech.cn)

邮箱：[daixibing@aeroptics-tech.cn](mailto:daixibing@aeroptics-tech.cn)